

华润微电子有限公司

投资者关系活动记录表

(2024 年 10 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）		
参与单位名称	10 月 31 日 10:00-11:00 申万宏源 华创证券 平安证券 西南证券 华鑫证券 财通证券 国海证券 德邦证券 广发证券 瑞穗证券 中山证券 花旗环球金融 盛博香港 兴业证券 易方达基金 中天汇富基金 英大基金 吕梁小金地 华杉瑞联基金 鲍尔赛嘉投资 北京才誉资产 北京富智投资 国信证券 西部证券 摩根证券 国盛证券 华泰证券 招商证券 国金证券 海通证券 摩根大通 瑞银证券 中泰证券 华福证券 首创证券 湘财证券 太平基金 臻一资产 华夏基金 广东润达私募 广州泓闾私募 广州金新私募 杭州玖龙资产 杭州量界投资 开源证券 中信证券 东北证券 长城证券 浙商证券 华西证券 国联证券 中信建投证券 申银万国证券 国泰君安证券 摩根士丹利 浦银国际 天风证券 野村东方国际证券 中国国际金融 君翼博星创业投资 青岛城投城金控股集团 青岛富实资产 青岛朋元资产 上海天驷资产 上海博笃投资 上海硅产业集团		

	北京涇谷私募 北京怡康资产 成都嘉瑞投资 创富兆业金融 创金合信基金 敦和资产 观富资产 尚诚资产 深圳丞毅投资 深圳红方私募 深圳红石榴投资 深圳远望角投资 重庆市金科投资 卓文博宇投资 XL Equities IGWT Investment	灏浚投资 鸿运私募 湖南源乘私募 嘉兴鑫扬私募 君义振华咨询 中邮保险资产 联创投资集团 宁波明盛资产 盛钧私募 松桥资本 赢舟资产 云富投资集团 兴亿投资 融通基金 Point72 S&P Global Market Intelligence	上海贵源投资 上海国投先导私募 上海瀚伦私募 上海金恩投资 上海雷钧资产 上海聆泽投资 上海盘京投资 上海磐耀资产 上海七叶树资产 上海谦心投资 上海钦沐资产 上海睿胜投资 上海徐汇资本投资 上海英谊资产 Open Door Investment
时间	10 月 31 日 10:00-11:00		
地点	无锡		
上市公司接待人员姓名	李 虹 华润微电子董事、总裁 吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘		
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2024 年三季度经营发展情况简介 回顾过去的三个季度，公司充分发挥 IDM 商业模式的优势，大力拓展 AI、物联网、自动驾驶、5G 等新兴市场。报告期内，公司实现营业收入 74.72 亿元，实现归母净利润 4.99 亿元。其中第三季度实现营业收入 27.11 亿元，环比增长 2.53%，同比增长 8.44%；三季度毛利率 28.43%，环比提升 2.09 个百分点，延续了二季度以来的良好势头。同时，研发投入金额达到 8.89 亿元，同比增长 2.28%，反映出公司在追求经济效益的同时，更加重视科技创新对长远发展的支撑作用。 在重点产品的终端领域转型升级方面，MOSFET 产品市场份额在汽车、通信、工控等中高端领域持续提升；IGBT 产品		

在工业和汽车电子领域的销售占比超 70%，其中电机驱动营收大幅增长，车规产品稳定上量；第三代半导体持续向中高端应用推广，SiC JBS 和 SiC MOS 产品围绕汽车电子、充电桩、光伏逆变、服务器电源等领域全面推广上量；氮化镓在手机快充、LED 电源应用外，不断拓展工控、通讯领域，产品系列丰富、性能显著提升。

二、投资者的主要问题

问题一：请问公司如何展望各个领域的需求情况？

答：从细分领域来看，消费领域整体需求稳定，其中家电以旧换新政策有一定拉动作用；工控领域需求企稳，国产替代趋势加强；汽车电子领域是公司重点发力方向，在产品系列、客户拓展方面有较好预期；新能源领域需求有所恢复但仍有价格压力。

问题二：请问公司对于明年 MOSFET 的展望？

答：公司将依托 12 吋先进性和 8 吋特色化产线优势，不断优化产品结构与市场布局，积极挖掘新兴市场并拓展客户资源，我们有信心明年 MOSFET 产品仍能实现增长。

问题三：请问公司目前产能利用率及后期展望？

答：自今年二季度起，6、8 吋产能利用率均在 90%以上。根据三季度接单情况看，四季度基本保持满载状态。

问题四：请问公司对于收并购的态度？

答：内涵式增长与外延式发展是公司发展的两条主线，公司一方面抓现有业务，包括重大项目建设、科技创新等，一方面持续开展投资并购工作，积极与契合公司战略的企业探讨

	未来互利共赢的合作方案，投资的方向主要围绕功率半导体、智能传感器、智能控制三大领域。 问题五：矽磐微电子先进封装（PLP）业务国内领先，请问目前客户情况及后续规划？ 答：矽磐微电子已拥有全球尺寸最大的面板级扇出封装生产线，扇出封装相关专利数量国内领先，IC 类集成电路扇出封装量产规模国内第一，技术达到国际先进、国内领先水平。项目正处于高速发展阶段，营收及产出同比均实现翻倍增长。客户方面已拓展国内头部的新能源汽车与动力电池客户，后续将继续推进相关技术节点的量产化能力。 问题六：请问公司代工业务毛利率始终保持稳定的原因？ 答：公司代工业务受益于 BCD 特色工艺优势、客户基础稳定等因素，同时积极调整产品结构，高等级产品销售占比稳步提升，在 BMS、隔离器、POE、IOT 等多个领域实现突破，并在代工工艺平台实现汽车级产品验证，公司 0.11um BCD、0.15um 高性能 BCD、新一代 HVIC、CMOS-MEMS 单芯片集成喷墨打印头等多平台技术产品进入风险量产。 问题七：请问公司未来在汽车电子领域的重点发力方向？ 答：公司的目标是更多产品进入主驱、电机控制等核心应用，通过产品组合形成解决方案，不断提升市场份额和综合竞争力。 问题八：请问除了功率半导体产品，公司看好哪些车规产品的未来空间？ 答：公司认为功率 IC 及 MCU 等产品在汽车领域的国产化应用
--	--

	趋势正持续增强。 问题九：请问公司有哪些产品可以应用在数据中心？ 答：公司中低压 MOS、高压 MOS、SiC 产品可应用于 AI 设备、算力设备及大型服务器场景中，正处于快速上量阶段。 问题十：请问公司认为设备更新及家电以旧换新是否对订单有所拉动，对于明年的景气度如何展望？ 答：以旧换新政策传导叠加市场需求回暖，从终端看确实产生了一定的拉动作用，特别是在白电领域效果更为明显。明年来看，随着 AI、5G、物联网等新兴领域快速发展，以及汽车电动化、智能化转型的趋势，我们预计景气度将好于今年，市场需求有望增加。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 10 月